W/Ta纳米层状金属的拉伸力学性能 和塑性变形机制

刘雪鹏^{1,2,3},颜家豪^{2,3}

(1.合肥工业大学土木与水利工程学院工程力学系,安徽合肥230009;2.合肥工业大学机械工程学院机械设计工 程系,安徽合肥230009;3.合肥工业大学航空结构件成形制造与装备安徽省重点实验室,安徽合肥230009)

摘要:W/Ta纳米层状金属是一种典型的BCC/BCC结构的层状金属材料,在核聚变装置中具有广阔的应用前景。本文采用 原子尺度分子动力学方法研究了W/Ta纳米层状金属在单轴拉伸过程中的力学性能和塑性变形行为,进一步分析了调制周期 对W/Ta纳米层状金属力学响应的影响。结果表明,W(110)/Ta(110)界面上会形成网络状的失配位错结构,它不仅可以作 为位错形核的源头,而且可以吸收层状金属结构中的位错。微结构演化分析表明,拉伸过程中主要经历三个变形阶段,即线弹 性、塑性屈服和塑性流变阶段。位错首先在Ta层中形核扩展,导致应力急剧下降,随后Ta层中的位错穿越界面至W层中并增 殖扩展,导致W层发生屈服。试样的塑性屈服主要由Ta层主导,流变阶段的塑性变形由W层和Ta层中的位错及其演化共同 决定。调制周期越大,界面数量越少,Ta层中位错形核较少,同样位错被界面吸收的数量较少而且界面阻碍位错的效果减弱, 因此屈服强度和平均塑性流变强度分别增加和降低。

关键词:纳米层状金属;分子动力学模拟;力学性能;塑性变形机制;调制周期
中图分类号:TB383;O313.1 文献标志码:A 文章编号:1004-4523(2025)03-0637-08
DOI:10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.021

Mechanical properties and plastic deformation mechanisms of W/Ta nanoscale metallic multilayer under tension

LIU Xuepeng^{1,2,3}, YAN Jiahao^{2,3}

(1.Department of Engineering Mechanics, College of Civil Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;
 2.Department of Mechanical Design Engineering, School of Mechanical Engineering, Hefei University of Technology,
 Hefei 230009, China;
 3.Anhui Province Key Lab of Aerospace Structural Parts Forming Technology and Equipment,
 Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

Abstract: W/Ta nanoscale metallic multilayer is a typical body-centered cubic/ body-centered cubic nanolayered composite, which is very promising for the application in nuclear fusion devices. Based on atomistic molecular dynamic (MD) simulations, we investigate the mechanical properties and plastic deformation mechanisms of W/Ta nanolayered composite under uniaxial tension, and further analyze the influence of modulation period on the mechanical response of W/Ta nanolayered composite. The results show that the W(110)/Ta(110) interface forms a misfit dislocation network, which can not only serve as the source for dislocation nucleation but also adsorb the dislocations in the metallic multilayer. The microstructure evolution analysis shows that, W/Ta nanolayered composite mainly experiences three deformation stages during stretching, i.e. linear elastic, plastic yield, and plastic flow stages. The dislocations in the Ta layers pass through the interfaces and enter into the W layers, and the propagation and slip of the dislocations in the flow stage is jointly governed by the dislocations and their evolution in both the W and Ta layers. With an increase of modulation period, the number of interfaces in the W/Ta metallic multilayer decreases, so that the nucleation of dislocations decreases as well as the amount of dislocations adsorbed by the interfaces decreases. In addition, the decreased number of the interface weakens the effect of hindering dislocations by interface. Therefore, the yield strength increases and the averaged plastic flow strength decreases.

收稿日期: 2024-01-24; 修订日期: 2024-04-02

基金项目:国家自然科学基金资助项目(12272118);国家磁约束核聚变能发展研究专项项目(2022YFE03030003)

Keywords: nanoscale metallic multilayer; molecular dynamics simulation; mechanical properties; plastic deformation mechanism; modulation period

纳米层状金属材料是由两种或多种纳米金属薄 膜通过周期性堆垛而形成的多层结构复合材料。其 中,纳米层状金属材料中每相邻两层组元构成一个 周期,其厚度称为调制周期^[1]。由于拥有高密度的 异相界面,纳米层状金属材料表现出比普通单相纳 米晶金属更为优异的强度和延展性^[2]。此外,交替 堆叠的设计能够综合各纳米组元层的优点,克服单 一组元层的局限性,使得纳米层状金属材料呈现出 优异的电学、磁学、光学、力学以及抗辐照性能^[34]。 因此纳米层状金属材料在航空航天、高端装备、国防 军工、核工业和生物医学等高尖端技术领域都有广 泛的应用前景^[56]。

力学性能作为衡量纳米层状金属材料性能的一 项极其重要的指标,直接决定着纳米层状金属材料 在工程应用中的服役表现^[7]。纳米层状金属材料的 界面类型可以分为三种:共格界面、半共格界面和非 共格界面^[8]。大量实验和模拟研究表明,纳米层状 金属材料的力学性能与材料内部位错、孪晶等缺陷 的运动、增殖和湮灭密切相关^[9]。通常来说,纳米层 状金属材料的变形和破坏发生在纳米或原子尺度 上。然而,受当前实验技术的限制,目前人们还很难 在原子尺度下对纳米层状金属材料的塑性变形过程 以及相关的微结构缺陷的演化特征进行实时观察。 分子动力学模拟不仅能够直接观察材料在原子尺度 下的微结构演化,还可以系统快速地设定结构参数、 体系尺寸以及外部条件等,为研究纳米层状金属材 料的力学性能和变形机制提供了新的思路。

近年来,世界各国的科学研究者针对纳米层状 金属材料的力学性能和塑性变形机制进行了大量的 分子动力学模拟研究。WENG 等^[10]研究了三种不 同孪晶界面类型(共格、半共格和非共格界面)的 Cu/Ni纳米层状金属材料的力学强化机制,结果表 明共格孪晶界面通过塑性变形能够产生显著的强化 效应。YIN等^[11]研究了Cu/Al纳米层状金属结构在 压缩加载下的界面结构演化和变形机制,发现 Cu/Al纳米层状金属的压缩应力-应变曲线有两个 主要的屈服点,其中第一个屈服点由界面失配位错 分解导致,第二个屈服点与位错从A1层穿越至Cu 层相关。AN等^[12]研究了组元层厚和温度对Ti/Al 纳米层状金属材料变形机制的影响规律,结果表明 材料的屈服强度随着层厚和温度的降低而增加。 WANG 等^[13]的模拟研究表明对 Cu/Ni 纳米层状金 属材料的结构引入非均质性可以显著增强组元之间 的协同变形性。在此基础上,系统研究了一种典型 非均质 Cu/Ta 夹层纳米层状金属材料在单轴拉伸 和压缩下的力学响应和层间协同变形性^[14]。此外, 研究人员采用分子动力学模拟对其他不同类型的纳 米层状金属材料的力学性能和变形机制进行了研 究,如 Cu/Nb^[15]、Ti/Ni^[16]、Ni/Co^[17]、Cu/Fe^[18]等体 系。然而,大多数的模拟研究主要集中于面心立方 (FCC)/FCC 或 FCC/体心立方(BCC)结构的纳米 层状金属材料,关于 BCC/BCC 结构的纳米层状金 属材料力学特性以及变形机制的研究还较少。

钨具有高熔点、高热导性以及优异的抗辐照性 能,被认为是国际热核实验反应堆(ITER)中最具前 景的面向等离子体材料^[19]。然而,钨属于过渡金属 材料,具有低韧性的特点,表现出显著的室温脆性行 为和较高的脆性-韧性转变温度,极大地限制了其在 核聚变工程上的应用^[20]。为了能够使钨很好地应用 在核聚变装置中,必须提高钨的塑性变形能力。研 究人员发现,W/Ta层状金属复合材料是解决这个 问题的一条有效途径。ZHANG 等^[21]研究发现增加 W 层和 Ta 层的层厚比可以显著提高 W/Ta 层状金 属材料的断裂韧性。此外, CHEN等^[22]研究了 W/Ta半共格界面上的氦泡形核和生长过程,发现 界面失配位错对氦泡的形核和生长有显著的影响。 W/Ta纳米层状金属材料作为一种典型的BCC/BCC 结构的层状金属结构,目前人们对其力学响应及塑 性变形机制研究得还很少。

基于此,本文将在室温下采用分子动力学模拟 对W/Ta纳米层状金属进行单轴拉伸,研究纳米尺 度下W/Ta纳米层状金属的力学性能和微观变形机 制,并探讨调制周期对其力学响应的影响。

1 模型构建与模拟方法

1.1 模型构建

为了模拟W/Ta纳米层状金属在室温下的单轴 拉伸行为,首先使用ATOMSK软件^[23]构建W/Ta纳 米层状金属的原子尺度模型。如图1(a)所示,晶体模 型沿x,y,z三个方向的尺寸分别为6.6、18.6和54.9 nm,共包含约40万个原子。W层和Ta层在三维空间 的晶向分别为x: [111]_w||[111]_{Ta};y: [112]_w||[112]_{Ta}; z: [110]_w||[110]_{Ta}。本文研究了5种不同调制周期(用 符号 λ 表示)的W/Ta纳米层状金属,分别为 λ = 9.14、 10.97、13.71、18.29和27.43 nm,图1(b)给出了不同调 制周期的W/Ta纳米层状金属的原子尺度模型。实 际上,上述给出的调制周期 λ 均为近似值,钨和钽的真





实层厚 h_w 和 h_{Ta} 可以通过公式 $h_W = \sqrt{2} a_W$ 和 $h_{Ta} = \sqrt{2} a_{Ta}$ 计算得出,其中, $a_W = 0.3165$ nm 和 $a_{Ta} = 0.33$ nm分别为单晶W和Ta的晶格常数。

1.2 模拟设置

为了得到W/Ta纳米层状金属在进行加载过程 之前的平衡构型,首先采用共轭梯度算法在绝对零 度下对体系进行能量最小化。随后,在等温等压 (NPT)系综下对W/Ta纳米层状金属进行弛豫,弛 豫过程中控制温度为300K,且三个方向的压强均为 0 Pa,时间步长设置为1 fs,弛豫时间为200 ps。结构 弛豫达到热力学平衡后,在等温-等压(NPT)系综中 以10°/s的恒定应变速率对试样进行单向拉伸。如 图1(b)所示,拉伸时加载方向平行于W/Ta界面,即 沿着 y方向,时间步长仍然为1 fs。为了能够模拟真 实三维块体W/Ta纳米层状金属的力学性质,在结构 弛豫和拉伸加载过程中三个方向均设置为周期边界 条件。采用开源的分子动力学模拟软件包 LAMMPS^[24]对W/Ta纳米层状金属进行计算模拟。 采用OVITO软件^[25]对模型在拉伸过程中的微结构 演化进行可视化和后处理分析。利用位错提取算法 (DXA)^[26]对模型内的位错进行识别和分析。采用共 近邻分析方法(CNA)^[27]区分不同晶体结构的原子。

1.3 原子势函数

在分子动力学模拟中,原子间相互作用势的选

取至关重要,它直接影响模拟结果的准确性和可靠性。本文采用 CHEN 等^[28]提出的修正的Finnis-Sinclair型W/Ta二元合金势函数来描述W/Ta纳米层状金属中原子间的相互作用,其研究工作表明,基于此势函数计算得出0K下单晶Ta的晶格常数为3.304Å,和实验值3.3039Å^[29]吻合得很好。此外,该势函数能够准确地描述W/Ta半共格界面上氦泡的形核和生长过程^[22]。

2 模拟结果与分析

2.1 界面结构及其特性

纳米层状金属材料的界面对其力学行为和塑性 变形机制方面起着非常重要的作用^[30]。由于W层 和Ta层具有不同的晶格常数,其晶格之间存在明显 的失配,因此导致W/Ta纳米层状金属中的W层和 Ta层之间形成了半共格界面。图2(a)给出了 W/Ta纳米层状金属弛豫之后的($\overline{1}10$)半共格界面 的失配位错结构,如图中所示,W/Ta纳米层状金属 的半共格界面上形成了一个网络状的失配位错结 构,其由三种不同的失配位错组成,它们的伯格斯矢 量分别为1/2[$\overline{1}11$]、1/2[$1\overline{1}1$]和[$0\overline{1}0$]。其中 [$0\overline{1}0$] 位错可以看成其他两种位错合成所得: [$0\overline{1}0$] = 1/2[$\overline{1}11$]+1/2[$1\overline{1}1$]。图2(b)给出了 W/Ta界面的原子平均正应力云图,从图中可以清 晰地观察到位于位错附近的原子所承受的应力 较大。





2.2 W/Ta纳米层状金属的力学性能

图 3 给出了 5 种不同调制周期的试样在 300 K 温度下的应力-应变曲线图。W/Ta纳米层状金属

在拉伸过程中,首先进入弹性变形阶段。在初始的 弹性变形阶段,W/Ta纳米层状金属的应力随应变 线性增加,且5种不同试样的应力-应变曲线几乎是 重合的。在达到最大应力(屈服强度)后,应力快速 下降,表明试样开始进入塑性变形阶段。如图3所 示,5种不同试样的应力-应变曲线具有类似的形状, 且每条曲线上均只存在一个应力峰值(如图3中椭 圆区域所示)。图4(a)给出了不同调制周期λ $(9.14 \text{ nm} \leq \lambda \leq 27.43 \text{ nm})$ 的 W/Ta 纳米层状金属 在单向拉伸下的屈服强度。不同调制周期λ的W/Ta 纳米层状金属的屈服强度在16.7~18.4 GPa之间。 当调制周期λ较小时,W/Ta纳米层状金属的屈服强 度随着λ的增大而显著增大。但当λ大于13.71 nm 时,W/Ta纳米层状金属的屈服强度随调制周期的 增加而缓慢增加。这可能是由于调制周期较大时, W/Ta纳米层状金属塑性变形机制对 A 的变化不敏 感。当加载应变继续增加,试样进入塑性流变阶段。 在此阶段,应力会随着应变的变化发生一定扰动,但 始终围绕着一个均值进行波动。定义平均塑性流变 强度为试样在塑性流变范围内的应力平均值。图 4(b)给出了不同调制周期λ的W/Ta纳米层状金属的 平均塑性流变强度。随着调制周期λ的增加,W/Ta纳 米层状金属的平均塑性流变强度呈下降趋势。



图 3 不同调制周期的W/Ta纳米层状金属的拉伸 应力-应变曲线

Fig. 3 Stress-strain curves of W/Ta nanoscale metallic multilayer with different modulation periods under tension



(a) 不同调制周期的W/Ta纳米层状金属的屈服强度
 (a) The yield strengths of W/Ta nanoscale metallic multilayer with different modulation periods



multilayer with different modulation periods

图 4 不同调制周期下 W/Ta纳米层状金属的屈服强度和平 均塑性流变强度的变化

Fig. 4 The yield strength and mean plastic flow strength of W/Ta nanoscale metallic multilayer with different modulation periods

2.3 W/Ta纳米层状金属的变形机制

选择调制周期 $\lambda = 13.71$ nm的试样对W/Ta 纳米层状金属在单向拉伸加载下的变形机制进行 研究。图 5 给出了 $\lambda = 13.71$ nm 试样的拉伸应 力-应变曲线图,其中A、B和C三点对应的应变分 别为9.2%、9.5%和10.7%。以加载前的W/Ta纳 米层状金属试样为参照,用DXA功能分析对变形 过程进行监测。图6显示了 $\lambda = 13.71$ nm的W/ Ta纳米层状金属在300K温度下单向拉伸时的位 错演化过程。为了便于观测和分析,将W层和Ta 层的位错赋予不同颜色加以区分。其中,Ta层中 绿色的位错为1/2 <111>型位错,蓝色的位错为 <100>型位错;W层中品红色的位错为1/2< 111>型位错。在小应变范围内($0 \leq \epsilon \leq$ 9.0%), W/Ta纳米层状金属处于弹性变形阶段, 在W层和Ta层中均未观察到缺陷的产生。当应 变增加到 $\epsilon = 9.1\%$,少量的1/2 < 111 > 型位错开



图 5 调制周期为λ = 13.71 nm 的 W/Ta 纳米层状金属的 拉伸应力-应变曲线

Fig. 5 Tension stress-strain curve of W/Ta nanoscale metallic multilayer with $\lambda = 13.71$ nm



图 6 调制周期为 λ = 13.71 nm 的 W/Ta 纳米层状金属在 拉伸过程中的微位错演化

Fig. 6 Dislocation evolution of the W/Ta nanoscale metallic multilayer with $\lambda = 13.71$ nm under tension

始在界面Ta层一侧形核(如图6(a)所示),表明 Ta层开始进入塑性变形阶段,此时应力还没有下 降。这主要是由于界面上的高应力导致界面上的 1/2[11]位错分解为1/2[11]和[001]位错,如 图 7(a) 所示。[001] 位错不能滑移并且其核结构 保持在原先的失配位错位置上,然而1/2[111]位 错快速扩展至Ta层中,如图7(a)所示。图8给出 了单晶W和Ta金属纳米线在300K温度下单轴 拉伸的应力-应变曲线。如图8所示,单晶W的抗 拉屈服强度(32.2 GPa)显著高于单晶Ta (15.8 GPa),因此位错是先在半共格界面Ta层一 侧形核并向其内部扩展。当应变增加到ε= 9.2%(图5中的A点)时,Ta层中形核的位错明显 增大(如图6(b)所示),试样的应力开始进入下降 阶段(如图5所示)。随着应变继续增大,位错在 Ta层中不断增殖扩展(如图6(c)所示),导致应力 开始急剧下降。由于半共格界面的阻碍作用,此 时Ta层中的位错不能穿过半共格W/Ta界面进 入到W层。DXA功能分析表明,Ta层内位错类



Fig. 7 Nucleation mechanism of dislocations in the Ta layer and W layer

型主要是 1/2 < 111>型位错以及少量的 < 100> 型位错。当应变增大到 9.5%(图 5 中的 B 点)时, 新的 1/2 < 111>位错开始在界面处的 W 层一侧出 现(如图 6(d)所示),表明 W 层开始发生塑性变 形。为了更好地理解 W 层一侧位错的形成机制, 显示了 W 层位错形成前后界面两侧的位错分布 图。如图 7(b)所示,当应变为 $\epsilon = 9.4\%$ 时,界面 处 Ta 层一侧存在 1/2 < 111>型位错而 W 层一侧 没有位错。当应变增加到 $\epsilon = 9.5\%$ 时,界面 W 层 一侧出现 1/2 < 111>型位错而 Ta 层一侧的 1/2 <111>型位错消失。这表明界面处 W 层一侧产生 的位错是由 Ta 层中的 1/2 < 111>型位错穿越界 面形成。

随着应变再继续增大,位错在W层中不断增殖 扩展。此外,Ta层中的位错数量也持续增多,并且 层内有一定数量的<100>型位错生成(如图6(e) 所示)。W层和Ta层中位错的增值和扩展导致应 力继续快速下降。当应变达到10.7%(图5中的C 点)时,W/Ta纳米层状金属中各个组元层都存在着 数量众多的位错(如图6(f)所示)。DXA功能分析 表明W层中的位错主要是1/2<111>型位错。当 继续施加载荷,Ta层中的位错继续增殖扩展,而W 层中的位错数量明显减少。从图6(e)和6(f)中的虚 线方框可以发现,W层中的位错基本消失了。这主 要是因为W层中的位错与界面相互作用,导致位错 被界面吸收。为了更加直观地观察位错数量的变 化,绘制了W层和Ta层中位错密度随应变的变化 曲线,如图9所示,当应变从10%增加到10.7%,可 以清晰地看到Ta层中的位错密度显著增加,而W 层中的位错密度明显减小。虽然W层中的位错活 动水平明显降低,但Ta层中位错数量的增加导致应 力急剧下降,这表明W/Ta纳米层状金属的塑性屈 服主要由Ta层主导。由于W和Ta都是BCC金属, 它们的层错能较高,因此在拉伸变形过程中没有观 察到层错的存在。





Fig. 8 Tension stress-strain curves of single crystal W and single crystal Ta



图 9 λ=13.71 nm 时 W 层与 Ta 层内位错密度随应变的变 化曲线

Fig. 9 Variation curves of ardislocation density with strain in W layer and Ta layer at λ =13.71 nm

当应变达到10.7%(图5中的C点)时,试样开 始进入塑性流变阶段。该阶段一个典型的特征是应 力随着应变的变化在一定范围内上下波动。图 6(f)~6(i)显示了W/Ta纳米层状金属在塑性流变 阶段的位错演化过程。当应变从10.7%增加到 15.5%时,W层和Ta层中的位错数量均明显减少 (如图 6(f)、6(g)和图 9 所示)。从而导致应力-应变 曲线中 CD 段的应力增加(如图 5 所示)。当应变在 15.5%~21%范围内,W 层和 Ta 层中的位错数量明 显增加(如图 6(g)、6(h)和图 9 所示),从而导致应 力-应变曲线中 DE 段的应力逐渐减小(如图 5 所 示)。随着应变从 21%继续增加到 23%,W 层和 Ta 层中的位错数量持续减少(如图 6(h)、6(i)和图 9 所 示),从而导致应力-应变曲线中 EF 段的应力增大 (如图 5 所示)。从这些结果可以看出,W/Ta 纳米 层状金属在流变阶段的塑性变形由 W 层和 Ta 层中 的位错及其演化共同决定。

2.4 调制周期对 W/Ta 纳米层状金属力学响应的 影响

从前文的分析结果可知,W/Ta纳米层状金属 的屈服强度和塑性流变强度随着调制周期λ的增加 分别呈现增加和降低的趋势。为了理解这些现象, 对比了不同调制周期的W/Ta纳米层状金属的位错 结构。试样应力-应变曲线的最高点与Ta层中的位 错形核扩展有关,而Ta层中的位错形核是由界面上 的失配位错分解造成的。当调制周期λ增加时,W/ Ta纳米层状金属的组元层数目变少,因此界面数量 也减少;界面数量越少,Ta层中越难出现位错形核 扩展,因此应力-应变曲线的最高点升高,即屈服强 度增加。

图 10 给出了不同调制周期的 W/Ta纳米层状 金属在应变为19%的位错结构和数量。通过对比 可知,当λ较大时,W/Ta纳米层状金属中的位错数 量较多;然而当λ较小时,试样中的位错数量明显减 少。这主要是因为当调制周期λ减少时,W/Ta纳米 层状金属的组元层数目变多,进而导致界面数量也 增多。从图6中可以看出,W层和Ta层中的位错与 界面相互作用会导致层状结构中的位错数量被界面 吸收和储藏。一方面,界面数量越多,W/Ta纳米层 状金属中界面吸收的位错数量就越多,从而导致层 状结构中的位错数量减少,因此流变应力增加。计 算了三种典型调制周期($\lambda = 27.43$ 、13.71和 9.14 nm)的W/Ta纳米层状金属在塑性流变阶段的 平均位错密度。对于 $\lambda = 27.43$ 、13.71和9.14 nm的 样品,其塑性流变阶段的平均位错密度分别为 $(0.41\pm0.064)\times10^{17}$ 、 $(0.39\pm0.057)\times10^{17}$ 和 $(0.31\pm$ 0.059)×10¹⁷ m⁻²。这表明较小调制周期的 W/Ta纳 米层状金属在塑性流变阶段的位错数量明显少于较 大调制周期样品的位错数量。另一方面,界面数量 越多,其有效阻碍位错运动的效果越明显,从而对金 属层状材料起到了强化作用。因此,随着调制周期



λ 的减少, W/Ta 纳米层状金属的塑性流变强度 增加。

3 结 论

本文采用分子动力学模拟研究了W/Ta纳米层 状金属在拉伸时的力学性能和微结构演化规律,并 探讨了调制周期对层状金属结构力学响应的影响。 主要结论如下:

(1)W/Ta纳米层状金属的界面上形成网络状的失配位错结构,主要由1/2[111]、1/2[111]和[010]三种不同的位错组成。该半共格界面不仅可以作为位错形核的源头也可以作为储存器吸收层状结构中的位错。

(2)W/Ta纳米层状金属在拉伸过程中表现出 三个明显的变形阶段。首先是线弹性阶段;其次是 塑性屈服阶段,该阶段始于位错在Ta层中的形核与 扩展,引起应力显著下降,促使Ta层发生塑性变形。 接着,位错从Ta层穿过界面进入W层,并在W层中 增殖扩展,最终导致W层屈服。在此过程中,塑性 屈服主要由Ta层主导;最后是塑性流变阶段,此阶 段应力随应变的变化呈现一定波动,试样的变形行 为由W层和Ta层中的位错运动及其演化共同 决定。

(3)当调制周期增大时,界面数量的降低使得 Ta层内位错形核减少。同时,界面在塑性变形阶段 对位错的吸收能力下降,且其阻碍位错迁移的作用 减弱。在这些因素共同作用下,W/Ta纳米层状金 属的屈服强度与平均塑性流变强度呈现相反趋势: 前者因位错运动受限而增强,而后者因界面对位错 的吸收能力下降而降低。

参考文献:

- WANG J, MISRA A. An overview of interface-dominated deformation mechanisms in metallic multilayers
 [J]. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2011, 15(1): 20-28.
- [2] MARA N A, BHATTACHARYYA D, DICKER-SON P, et al. Deformability of ultrahigh strength 5 nm Cu/Nb nanolayered composites[J]. Applied Physics Letters, 2008, 92(23): 231901.
- [3] DIERCKS D, SVALOV A V, KAUFMAN M, et al. Structure and electrical resistivity of sputtered Tb/Ti and Tb/Si magnetic multilayers[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2010, 46(6): 1515-1518.
- [4] MISRA A, DEMKOWICZ M J, ZHANG X. The radiation damage tolerance of ultra-high strength nanolayered composites[J]. JOM, 2007, 59(9): 62-65.
- [5] SÁENZ-TREVIZO A, HODGE A M. Nanomaterials by design: a review of nanoscale metallic multilayers[J]. Nanotechnology, 2020, 31(29): 292002.
- [6] WIESENDANGER R. Nanoscale magnetic skyrmions in metallic films and multilayers: a new twist for spintronics[J]. Nature Reviews Materials, 2016, 1(7): 16044.
- [7] 曲绍兴,周昊飞.新型纳米结构金属材料的力学性能及变形机制[J].力学进展,2014,44(1):338-375.
 QU Shaoxing, ZHOU Haofei. Mechanical behaviors and deformation mechanisms of novel nano-structured metals[J]. Advances in Mechanics, 2014, 44 (1): 338-375.
- [8] ZBIB H M, OVERMAN C T, AKASHEH F, et al. Analysis of plastic deformation in nanoscale metallic multilayers with coherent and incoherent interfaces [J]. International Journal of Plasticity, 2011, 27 (10) :

1618-1639.

- [9] MISRA A, HIRTH J P, HOAGLAND R G. Lengthscale-dependent deformation mechanisms in incoherent metallic multilayered composites[J]. Acta Materialia, 2005,53(18): 4817-4824.
- [10] WENG S Y, NING H M, HU N, et al. Strengthening effects of twin interface in Cu/Ni multilayer thin films-A molecular dynamics study[J]. Materials & Design, 2016, 111: 1-8.
- [11] YIN F X, ZHAO Y Z, YU S Y, et al. Molecular dynamics studies on the interface evolution characteristics and deformation mechanisms of Cu/Al multilayers during compression process[J]. Journal of Applied Physics, 2019, 125(2): 025112.
- [12] AN M R, DENG Q, SU M J, et al. Dependence of deformation mechanisms on layer spacing in multilayered Ti/Al composite[J]. Materials Science and Engineering:A, 2017, 684: 491-499.
- [13] WANG Y D, LI J J, LU W J, et al. Enhanced co-deformation of a heterogeneous nanolayered Cu/Ni composite[J]. Journal of Applied Physics, 2019, 126(21): 215111.
- XU K Z, ZHAI H, HE L H, et al. Atomistic simulations of mechanical response of a heterogeneous FCC/ BCC nanolayered composite[J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2022, 34(38): 385703.
- [15] DEMKOWICZ M J, HOAGLAND R G, HIRTH J P. Interface structure and radiation damage resistance in Cu-Nb multilayer nanocomposites[J]. Physical Review Letters, 2008, 100(13): 136102.
- [16] SU M J, DENG Q, AN M R, et al. Molecular dynamics study of the tensile behaviors of Ti(0,0,0,1)/Ni(1, 1,1) multilayered nanowires[J]. Computational Materials Science, 2019, 158: 149-158.
- [17] VU T N, PHAM V T, NGUYEN V T, et al. Interfacial strength and deformation mechanism of Ni/Co multilayers under uniaxial tension using molecular dynamics simulation[J]. Materials Today Communications, 2022, 30: 103088.
- [18] LIN Z J, PANG W W, XIN K, et al. The effect of loading strain rates on deformation behavior of Cu/Fe composite[J]. Physics Letters A, 2021, 388: 127070.
- [19] TOKAR M Z, COENEN J W, PHILIPPS V, et al. Tokamak plasma response to droplet spraying from

melted plasma-facing components[J]. Nuclear Fusion, 2012, 52(1): 013013.

- [20] REN C, FANG Z Z, KOOPMAN M, et al. Methods for improving ductility of tungsten-a review[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2018, 75: 170-183.
- [21] ZHANG Y, OUYANG T Y, LIU D W, et al. Effect of thickness ratio on toughening mechanisms of Ta/W multilayers[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 666: 30-37.
- [22] CHEN K, XIE H X, QIE Y H, et al. Molecular dynamics simulation study of helium bubble growth on W/ Ta semi-coherent interface[J]. Journal of Nuclear Materials, 2022, 558: 153340.
- [23] HIREL P. Atomsk: a tool for manipulating and converting atomic data files[J]. Computer Physics Communications, 2015, 197: 212-219.
- [24] PLIMPTON S. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics[J]. Journal of Computational Physics, 1995, 117(1): 1-19.
- [25] STUKOWSKI A. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO-the open visualization tool[J]. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2010, 18(1): 015012.
- [26] STUKOWSKI A, BULATOV V V, ARSENLIS A. Automated identification and indexing of dislocations in crystal interfaces[J]. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2012, 20(8): 085007.
- [27] TSUZUKI H, BRANICIO P S, RINO J P. Structural characterization of deformed crystals by analysis of common atomic neighborhood [J]. Computer Physics Communications, 2007, 177(6): 518-523.
- [28] CHEN Y C, FANG J Z, LIU L X, et al. Development of the interatomic potentials for W-Ta system [J]. Computational Materials Science, 2019, 163: 91-99.
- [29] DEWAELE A, LOUBEYRE P, MEZOUAR M. Refinement of the equation of state of tantalum[J]. Physical Review B, 2004, 69(9): 092106.
- [30] BEYERLEIN I J, DEMKOWICZ M J, MISRA A, et al. Defect-interface interactions[J]. Progress in Materials Science, 2015, 74: 125-210.
- **通信作者:**刘雪鹏(1991一),男,博士,副研究员。 E-mail: liuxuepeng@hfut.edu.cn